



产品手册

郑州成越科学仪器有限公司

Zhengzhou CY Scientific Instruments Co., Ltd.

咨询电话: 400-800-1730

实验室成套设备定制专家





公司简介

COMPANY PROFILE

郑州成越科学仪器有限公司是一家专业从事科学仪器设计制造和实验耗材销售的科技公司。公司产品有:PVD(磁控溅射镀膜仪、等离子镀膜仪、多弧离子镀膜仪、热蒸发镀膜仪)、CVD、PECVD、MPCVD、超声波热解喷涂机、静电纺丝机、等离子清洗机、旋涂型匀胶机等多款产品。

近年来,公司在社会各界的关心支持下,不断发展壮大,与国内外众多知名高校和科研单位建立了合作关系。目前公司产品主要销往欧美、日韩等发达国家,同时在国内市场也获得了广大用户的一致好评,并得到了业界的高度认可。站在行业发展的潮头,我们立志成为先进材料制备设备的高端制造商,持续为基础科研助力!本公司提供材料实验室搭建一站式服务。

CONTENTS

----- 产品目录

桌面型单靶磁控镀膜仪	-----	01
桌面型双靶磁控镀膜仪	-----	02
粉体包覆磁控镀膜仪	-----	03
桌面型三源蒸发镀膜仪	-----	04
全自动匀胶机	-----	05
晶圆烤胶机	-----	06
等离子清洗机	-----	07
卷绕型狭缝涂布机	-----	08
桌面型平板涂布机	-----	09
无针型静电纺丝机	-----	10
超声波热解喷涂机	-----	11
原子层沉积系统 (ALD)	-----	12
等离子化学气相沉积系统 (PECVD)	-----	13
单温区旋转石墨烯制备炉	-----	14
实验研究型MPCVD	-----	15
放电等离子烧结炉 (SPS)	-----	16
小型电弧熔炼炉	-----	17
真空感应熔炼炉	-----	18
真空石墨热压炉	-----	19
1650°C布里奇曼晶体生长炉	-----	20
全自动金刚石线切割机	-----	21
粉末压片机	-----	22

专利证书

PATENT CERTIFICATE

NO:5467598



NO:12373812



NO:12576393



NO:12603656



NO:12269526



NO:19330745



NO:12352165



NO:19396466



NO:12274290



NO:19449896



NO:12629889



NO:12393562



■ 磁控溅射

桌面型单靶磁控镀膜仪

【CY-MSZ200-I-DC/RF-AL】

体积小易操作,适合多种材料,是实验室制备各类材料薄膜的理想设备。



桌面型单靶磁控溅射镀膜仪是一种紧凑型镀膜设备,采用磁控溅射技术在基片表面沉积薄膜。铝合金真空腔体,轻量化设计,耐腐蚀性好,适合实验室或小规模生产场景。体积小巧,适合科研院所、高校实验室等空间有限的场所。

● 主要参数

• 产品尺寸	L390*D400*H430mm
• 样品台尺寸	φ50mm
• 样品台转速	≤20rpm
• 腔体尺寸	φ190*150mm
• 腔体材料	铝合金
• 开启方式	上盖开启
• 电源配置	直流电源(500W)
• 整机功率	2KW

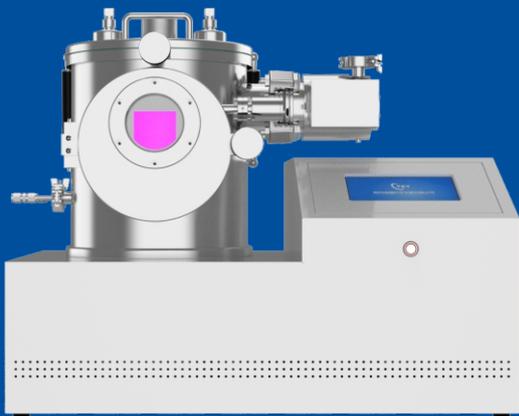


■ 磁控溅射

桌面型双靶磁控镀膜仪

【CY-MSZ254-II-DC/RF-SS】

配备双靶枪及双电源, 射频电源用于非导电材料溅射镀膜, 直流电源用于导电材料溅射镀膜。



本设备为双靶磁控镀膜仪, 可用于金属薄膜及非金属薄膜的制备, 在电子领域、光学领域、特殊陶瓷制备等领域均有应用, 也可实验室SEM样品制备。本套配置采用高真空不锈钢腔体, 腔体设置带挡板的石英观察窗, 便于实验的观察记录; 腔体设计真空性能优良, 造型小巧, 十分适合实验室使用。

● 主要参数

• 产品尺寸	L710*D480*H580mm
• 样品台尺寸	φ100mm
• 样品台转速	≤20rpm
• 腔体尺寸	φ273*300mm
• 腔体材料	304不锈钢
• 开启方式	上盖开启及前开门
• 电源配置	直流电源(500W)
• 整机功率	2KW



■ 磁控溅射

粉体包覆磁控镀膜仪

【CY-MSH150-I-RF-Q】

该设备主要用于粉体材料、颗粒材料的包覆制备,用于改善粉体或颗粒的表面性能、分散性能、稳定性,赋予其导电性、耐腐蚀性等新功能。



粉体包覆磁控镀膜仪是通过粉体在溅射腔室内的旋转,以达到粉体表面均匀包覆的效果。腔室可旋转、倾斜,能快速出料。粉体包覆是指将一种或多种粉体颗粒投入到包覆设备中,通过物理或化学方法形成一层覆盖在颗粒表面的物质。粉体包覆的目的可以是改变颗粒表面的性质、增加颗粒的稳定性、控制颗粒的释放速率等。

● 主要参数

• 产品尺寸	L1800*D630*H1100mm
• 靶材尺寸	Φ50.8mm,厚度≤3mm
• 冷却模式	循环水冷
• 腔体尺寸	φ100*φ150*φ100mm
• 腔体材质	高纯石英
• 溅射电源	RF电源,功率300W
• 控制系统	CYKY自研专业级控制系统
• 整机功率	3KW

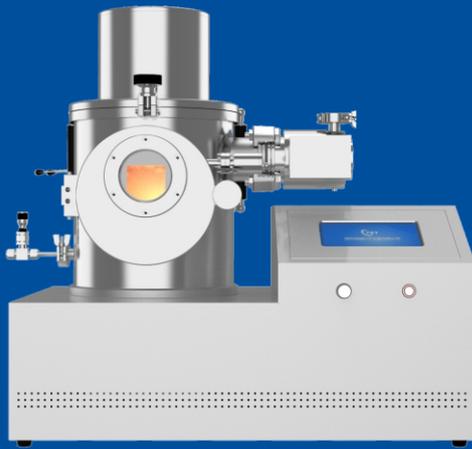


■ 蒸发镀膜

桌面型三源蒸发镀膜仪

【CY-MSZ254-III-H-SS】

本款设备配备三个蒸发源,是一款高真空蒸发镀膜仪,特别适合蒸镀对氧较敏感的金属膜(如Ti、Al、Au等)和小分子的有机物。



本产品为专为高真空设计的桌面型小型蒸发镀膜仪,可提供最大150A的镀膜电流,最大蒸发温度可达1800°C,能够满足各种常见金属的蒸镀及部分非金属蒸镀。配合分子泵组可达到 5×10^{-5} Pa极限真空,能够满足绝大部分材料蒸发所需的真空环境。真空腔体采用前开门开启方式,便于取放样,腔体上配置有带挡板的石英观察窗,用于观察镀膜过程,磁力耦合挡板则可以有效防止观察窗被膜料污染。

● 主要参数

• 产品尺寸	L710*D480*H690mm
• 样品台尺寸	φ100mm
• 样品台转速	≤20rpm
• 加热温度	≤300°C
• 腔体材料	304不锈钢
• 开启方式	前开门
• 蒸发源	坞舟(3个)
• 整机功率	2KW



■ 匀胶机

全自动匀胶机

【CY-SPC8-SS】

通过集成自动滴胶功能,设备实现了“滴胶精度-匀胶均匀性-工艺自动化”的一体化提升,尤其适合对涂覆精度要求高的场景(如微纳器件制备、光伏薄膜沉积等)。



本款全自动匀胶机配备自动滴胶装置,主要用于制备薄膜材料,其应用范围包括制备太阳能电池,制备金属、半导体、氧化物、聚合物等材料的薄膜,制备纳米材料、纳米结构、纳米薄膜等。

● 主要参数

• 供电电压	AC220V 50Hz
• 吸盘尺寸	可适配6英寸、8英寸铝合金真空吸盘
• 转速	20~10000rpm
• 转速分辨率	±1rpm
• 加速度	20~10000rpm/s
• 单步时长	3000s
• 滴胶方式	自动
• 操作方式	液晶屏操作系统



■ 烤胶机

晶圆烤胶机

【CY-HP200】

通过精准控温与自动化设计,晶圆烤胶机确保胶层固化过程的一致性与可靠性,是半导体制造、微机电系统(MEMS)等领域关键的工艺设备之一。



晶圆烤胶机在半导体及相关领域的光刻工艺中,主要用于光刻胶的烘烤和固化,确保图案转移的精确性和工艺稳定性。

● 主要参数

• 产品尺寸	L390*D367*H265mm
• 加热面板尺寸	230*230mm
• 温度分辨率	0.1°C
• 温度均匀性	±2%
• 控温范围	RT~300°C
• 控制系统	触摸屏操作, PLC控制
• 真空接口	KF16
• 重量	10Kg



■ 等离子清洗机

等离子清洗机

【CY-PC40K-6-SS】

用于金属、生物医疗、航空航天、电子、半导体等领域的材料表面的清洁、活化、改性及涂层处理。



等离子清洗机是借助等离子体中的高能粒子与活性基团,对材料表面进行清洁去污、活化粗糙化、改性刻蚀等处理的设备,可有效去除有机污染物与无机杂质,增加表面能并实现微观结构调控。其广泛应用于半导体制造中的芯片封装前处理、光刻胶灰化,光电显示领域的触摸屏玻璃预处理,以及新能源材料、医疗生物、纳米科研等场景,具备处理精度达纳米级、干式清洁无废液、兼容多种材料等显著优势。

● 主要参数

• 产品尺寸	L390*D367*H265mm
• 腔体尺寸	Φ196*30mm
• 射频功率	0~500W连续可调
• 真空测量	电阻式真空计
• 真空抽取	双级旋片泵
• 真空量程	1Pa~10000Pa
• 极限真空	1Pa
• 整机功率	1KW



■ 涂布机

卷绕型狭缝涂布机

【CY-AFC500R-HTUV】

卷绕型狭缝涂布机用于在连续卷绕的基材(如薄膜、金属箔等)通过狭缝模头精确涂布液料,实现均匀成膜,适用于电池极片、光学膜等涂布场景。



这是一款专为连续卷状柔性基材(如金属箔、塑料薄膜)设计的高精度涂布设备。通过精密狭缝挤出浆料或溶液,在高速运行的基材上形成均匀、超薄的湿膜(厚度精度可达 $\pm 1\mu\text{m}$),结合在线干燥/固化系统,实现高效、稳定的卷对卷(R2R)连续生产。适用于对涂布均匀性和一致性要求极高的领域,是新能源电池(电极/隔膜)、光学薄膜、功能性涂层及印刷电子等先进制造行业的理想选择。

● 主要参数

• 产品尺寸	L1610*D740*H460mm
• 最高温度	120°C
• 温控精度	$\pm 1^\circ\text{C}$
• 烘干区域	L340*W200mm
• 涂布宽度	200mm
• 导辊幅宽	260mm
• 收放卷径	$\Phi 240\text{mm}$
• 整机功率	3.5KW

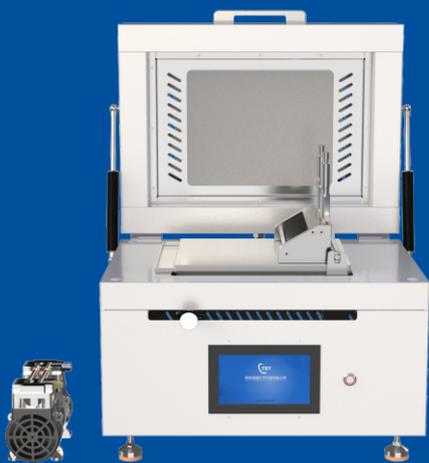


■ 涂布机

桌面型平板涂布机 (顶部烘干)

【CY-CMF-250×300-S-UV】

适用于实验室或小批量生产,可在玻璃、硅片等平板基材表面均匀涂布光刻胶、涂层液等材料。



专为实验室研发与小批量生产设计,可在硬质平板(玻璃/硅片/金属板)或小尺寸柔性基材上实现微米级精度涂布(如光刻胶、纳米功能涂层、电极浆料等),并同步完成可编程梯度烘干。一体式涂布-干燥流程有效避免湿膜损伤,显著提升涂层均匀性与工艺重现性,大幅加速新材料开发(钙钛矿太阳能电池、显示面板、传感器等)、工艺参数优化及原型样品试制进程,是科研机构与企业创新升级的高效工具。

● 主要参数

• 产品尺寸	L550*D400*H400mm
• 涂覆速度	0~100mm/s 可调
• 涂布行程	10~200mm 可调
• 真空铝板	L300*W250mm
• 真空泵	无油真空泵
• 制膜器	100mm 微米级可调式
• 加热方式	顶部紫外线(365nm)
• 最高温度	120°C



■ 静电纺丝机

无针型静电纺丝机

【CY-ES300-PP】

无针型静电纺丝机通过高压静电场制备纳米至微米级纤维,用于过滤材料、生物医疗、能源、柔性电子等领域。



本设备采用创新无针纺丝技术,通过高压电场直接在溶液表面生成纳米纤维,突破传统针头易堵塞瓶颈,实现高通量、连续化生产超细纳米纤维膜(直径50-500nm)。设备具备均匀成膜、材料适应性广等优势,专为生物医疗(组织工程支架/药物缓释膜)、高效过滤(空气/水净化)、能源(电池隔膜)及智能纺织等领域提供高性能纳米纤维制备解决方案,助力科研与产业升级。

● 主要参数

• 产品尺寸	L1000*D600*H900mm
• 加热方式	碳纤维红外加热
• 最高温度	80℃
• 注射器容量	50ml
• 流量范围	0.005~40ml/min
• 输出电压	30KV
• 最大电流	1mA
• 整机功率	1.6KW



■ 热解喷涂机

超声波热解喷涂机

【CY-TSC-150×150-TG】

超声波热解喷涂机通过超声雾化与热解在基材表面沉积功能涂层,用于新能源、电子、医疗、光催化等领域。



超声波热解喷涂系统采用高频超声波雾化技术,将液态前驱体(金属盐溶液/纳米颗粒悬浮液)转化为微米级均匀液滴,在高温反应腔中瞬时热解形成高纯度、高致密度的功能性薄膜(如氧化物、碳化物涂层)。设备集精准雾化、可控热解与均匀沉积于一体,专为制备燃料电池电解质层、催化电极、高温防护涂层、半导体功能薄膜等高性能材料设计,赋能新能源、航空航天及电子器件领域的尖端研发与量产。

● 主要参数

• 产品尺寸	L1100*D730*H1500mm
• 喷嘴	2个压缩空气喷嘴
• 注射泵数量	4个
• 注射器容量	60ml
• 注射器精度	$\leq \pm 0.5\%$
• 移动距离	(X~Y轴) $\leq 200\text{mm}$; Z轴 $\leq 60\text{mm}$
• 行驶速度	1mm/s~12mm/s
• 温度范围	RT~500°C



ALD

原子层沉积系统 (ALD)

【CY-ALD6-FL4】

原子层沉积系统通过交替通入反应气体在基材表面沉积原子层级的均匀的功能薄膜,用于半导体器件、催化剂载体、电池电极改性等领域。



原子层沉积系统(ALD)通过交替通入前驱体气体,在基材表面发生自限制性化学反应,实现亚纳米级精度薄膜沉积(精度 $\pm 0.1\text{nm}$)。具备极致三维保形性、无针孔缺陷等特性,专为半导体栅极介质、纳米器件封装、量子点钝化等原子级涂层需求设计。

主要参数

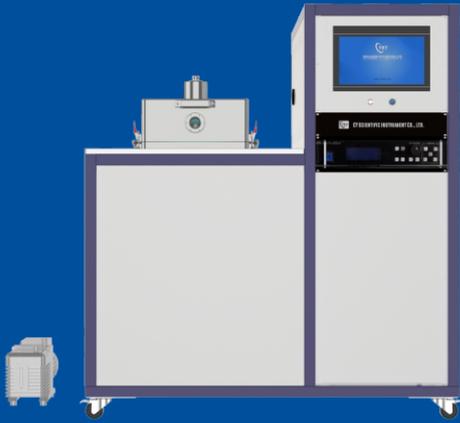
• 反应腔体	可生长最大6英寸样品
• 基底加热温度	RT~400°C可控
• 控制精度	$\pm 1^\circ\text{C}$
• 腔体烘烤温度	RT~200°C可控
• 前驱体管路	采用316L不锈钢管路(EP级)
• ALD 阀	原子层沉积专用高速高温ALD 阀
• 真空规	进口宽范围真空规
• 控制硬件	PLC 控制系统



■ CVD

等离子化学气相沉积系统(PECVD) 【CY-PECVD-500T-SS】

本设备在半导体制造、太阳能电池、光电子器件、MEMS、纳米薄膜、新能源汽车、医疗植入物、耐磨涂层、食品包装及工业控制等领域用于沉积各类功能薄膜以提升性能或提供保护。



本设备采用等离子体增强型化学气相沉积技术，能够利用高能量等离子体促进反应过程，有效提升反应速度，降低反应温度。适用于在光学玻璃、硅、石英以及不锈钢等不同衬底材料上沉积氮化硅、非晶硅和微晶硅等薄膜，成膜质量好、针孔较少、不易龟裂，适用于制备非晶硅和微晶硅薄膜太阳能电池器件，可广泛应用于大专院校、科研院所的薄膜材料的科研与小批量制备。

● 主要参数

• 产品尺寸	L1362*D736*H1434mm
• 加热温度	RT~400℃
• 温控精度	±1℃
• 样品台尺寸	φ200mm
• 样品台转速	1~20rpm 可调
• 喷头尺寸	φ200mm
• 观察窗	φ40mm
• 极限真空	5×10^{-4} Pa



■ CVD

单温区旋转石墨烯制备炉

【CY-OTF-1200X-I-PEC4】

本设备适用于无机复合粉体的热处理及粉体表面的均匀包覆(如:制备锂离子电池阴极粉体的导电涂层等)。



本设备为等离子增强型旋转石墨烯制备系统。设备由旋转及倾斜机构、单温区管式炉、等离子发生机构、质量流量计供气系统、高真空分子泵组等部分构成。相比于其他的石墨烯制备设备,本设备能够提供更高的基底真空,能够提高产物质量;能够利用旋转和倾斜机构实现连续生产,并且可以使颗粒型样品表面均匀生长产物;等离子发生装置能够显著降低反应温度,提高反应效率。

● 主要参数

• 炉管直径	φ100mm
• 炉管材质	高纯石英
• 炉管长度	1500mm
• 加热区长	400mm
• 工作温度	0~1100°C
• 控温精度	±0.1°C
• 控温模式	30段或50段程序控温
• 密封方式	304不锈钢真空法兰



■ MPCVD

实验研究型MPCVD

【CY-MPCVD】

用于化学气相沉积法制备高品质单晶金刚石、高品质多晶金刚石自支撑厚膜、高品质多晶金刚石薄膜、石墨烯、碳纳米管、富勒烯等。



本产品为不锈钢腔体式6kw微波等离子体设备，功率密度高，水冷式基片台和水冷式金属反应腔，保证系统能长时间稳定工作；基片温度以微波等离子体自加热方式达到；真空泵及阀门采用涡轮分子泵(极限真空为 1×10^{-5} Pa)和旋片式机械真空泵(极限真空为1Pa)，系统可自动控制沉积气压；全自动工艺控制模块，可以稳定可靠地制备高品质金刚石薄膜和晶体。

● 主要参数

• 供电电压	AC 380V(±10%)
• 样品台	电动升降式水冷基片台
• 样品台尺寸	φ100mm
• 基片台温度	250~1400°C(取决于工艺参数)
• 微波频率	2450±25MHz
• 工作气压范围	10~250Torr
• 自动稳压范围	40~250Torr
• 测温系统	德国Raytek红外测温系统

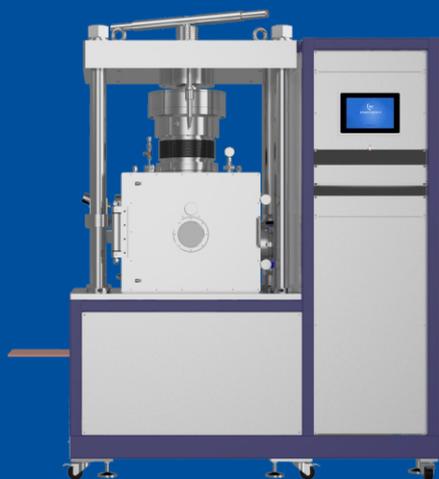


■ 放电等离子烧结炉

放电等离子烧结炉 (SPS)

【CY-SPS500-80KW-100T】

该技术具备烧结速度快、样品致密度高等优势,是制备纳米相材料、梯度功能材料、介孔纳米热电材料、稀土永磁材料、金属玻璃等非平衡态材料及生物材料的有力工具。



放电等离子烧结炉 (SPS) 是一种粉末快速固结的新型技术。SPS利用强电流的脉冲电源来激发和促进材料的固结和反应烧结过程。相较于传统技术,SPS在加工过程中,对各类导体、非导体以及复合材料的密度值均可调节至任意需求值。SPS最大程度的缩短了实验时间及能耗,同时又完美的保持了材料的微纳结构。因此自诞生以来,迅速成为了科学研究、新材料研发、产业生产等多个领域的重要利器。

● 主要参数

• 产品尺寸	L1350*D1575*H2000mm
• 脉冲频率	5~255 ms (可调) 2~1000 Hz (可调)
• 最高温度	2000°C
• 温控系统	采用高精度温控仪表
• 最大压力	100T
• 烧结区	100mm
• 最大升温速率	300°C/min
• 整机功率	100KW



■ 电弧熔炼炉

小型电弧熔炼炉

【CY-DHLΦ160-SS-Φ4-5】

该设备采用非自耗钨电极与水冷铜坩埚，配备机械操作杆以实现在不破坏真空及气氛环境下翻转样品，确保熔炼均匀性，还可选购真空吸铸功能，尤其适用于金属合金样品的精炼。



本品是一款小型真空电弧熔炼炉，采用钨电极和水冷铜坩埚。设备熔炼温度可超过3000℃，且降温迅速。采用不锈钢水冷腔体，配有观察窗口和照明窗口，可观测样品熔炼情况，非常适合样品熔炼和热处理，相图研究。熔炼时，金属放置在水冷铜坩埚内，炉内充入高纯的惰性气体，利用电弧产生的高温熔化金属。该设备具有体积小，性能稳定，操作简单方便等优点。

● 主要参数

• 产品尺寸	L660*D330*H820mm
• 熔炼温度	最高3000℃
• 腔体尺寸	Φ160×190mm
• 腔体材质	304不锈钢
• 电极	钨针(Φ4mm)
• 极限真空	1.0 ⁻⁴ Pa
• 进气阀门	不锈钢针阀
• 真空计	指针式真空计



■ 感应熔炼炉

真空感应熔炼炉

【CY-IV400-35KW-SS】

主要用于真空或惰性气氛环境中对铁基、镍基、钴基等高温合金, 稀土永磁材料, 钛合金, 铜合金, 贵金属及特殊功能金属材料进行熔炼、合金化及精炼。



真空感应熔炼炉在高真空/惰性气体双环境下, 通过电磁感应涡流直接加热金属材料, 实现无污染熔炼(氧含量 $\leq 5\text{ppm}$)、超精准合金化(成分偏差 $< 0.5\text{at}\%$)及定向凝固控制。专为活性金属(钛/锆)、高温合金、磁性材料及高纯单晶的研发而设计, 攻克易氧化组分熔炼、亚稳相调控等关键技术瓶颈, 赋能航空航天、核能、生物植入体等尖端材料创新。

● 主要参数

• 产品尺寸	L1340*D1240*H1650mm
• 供电电压	三相380V
• 最高温度	1800°C
• 腔体材质	304不锈钢
• 腔体尺寸	$\phi 400\text{mm} * \text{H}400\text{mm}$
• 感应线圈	内径90mm, 高90mm
• 温度控制	自动控制
• 整机功率	40KW



■ 石墨热压炉

真空石墨热压炉

【CY-IVP500-10T-SS】

主要用于在真空或保护气氛环境下对金属材料、陶瓷材料、复合材料等的热处理和热压连接。



该设备采用石墨作为加热体,可在高真空或惰性气氛环境中于2000℃高温下长期稳定工作。其核心功能在于为粉末冶金材料(如难熔金属钨钼合金、金属基复合材料)、结构陶瓷(氮化硅、碳化硅)、无机化合物(金属氧化物、碳化物)及纳米材料(纳米晶金属、陶瓷粉体)等提供真空或保护气氛下的加热压制环境,通过精准调控温场与机械压力的协同作用,实现材料的致密化成型与成品制备,尤其适用于需要抑制氧化、促进界面扩散或保留纳米尺度特性的工艺场景。

● 主要参数

• 产品尺寸	L1570*D1500*H1900mm
• 加热形式	石墨加热
• 最高温度	2000℃
• 最大压力	10T
• 极限真空	5×10^{-3} Pa
• 温度测量	红外测温仪
• 控温仪表	数显温度程序控制仪
• 整机功率	25KW



■ 晶体炉

1650°C布里奇曼晶体生长炉

【CY-O1650BG-φ80-100x100x100-V-T】

1650°C布里奇曼晶体生长炉主要应用于半导体材料领域,生长各种单晶体,包括硅、蓝宝石、氮化硅、碳化硅等,它可以生长高纯度、高质量和大尺寸的单晶体,用于生产半导体器件激光器、光电子器件等。



1650°C布里奇曼晶体生长炉是一种高温晶体生长设备,主要用于生长高质量、大尺寸的单晶体。其技术特点如下:1.高温能力强:1650°C布里奇曼晶体生长炉可以达到非常高的工作温度,可以满足许多高温晶体生长需求。2.温度控制精度高:该炉子采用先进的温度控制技术,可以实现高精度的温度控制,确保晶体制备的质量和可靠性。3.设备结构合理:该炉具有合理的结构设计,保证了晶体生长的均匀性和稳定性。

● 主要参数

• 供电电源	220V 50HZ
• 最大功率	15KW
• 加热元件	硅钼棒
• 加热区	三温区,每个温区长度100mm
• 控温精度	±0.1°C
• 控温系统	采用PID方式控温
• 样品台	Φ60*100mm氧化铝样品台
• 工作温度	≤1650°C



■ 切割机

全自动金刚石线切割机

【CY-DWC-M1212】

本设备适用于切割不同硬度的材料,如陶瓷、晶体、玻璃、金属、岩石、热电材料、红外光学材料、复合材料以及生物医学材料等。



本设备用在贵重宝石、生物塑化标本的切片时,不仅切缝细小而且切割片质量优良,大幅度提高了材料的利用率。本设备是连续切割型金刚石线切割机,设置好切割程序后试样连续进给,无需手动调节,切割后的样品尺寸精度高,在士10 μ m的范围内。本设备的切割线采用单根线循环往复的运动模式,可使用的线的长度长(≤ 270 m),一次上线的使用寿命长,大大提高了切割效率。张紧轮采用气动张紧的模式,气压的大小可根据线径的粗细进行调整,当所使用线径过细时可有效的保护切割线不会因张紧力过大而断裂。

● 主要参数

• 供电电源	220V 50HZ
• 最大功率	550W
• 主轴电机	交流变频电机,功率400W
• Y、Z、R轴电机	精密步进电机
• 切割线总长	≤ 150 m
• 切割线直径	≤ 20.45 mm
• 切割样件尺寸	$\phi 300$ mm*300mm(max)
• 安全控制装置	断线自停、急停开关



■ 压片机

粉末压片机

【CY-600A】

主要用于将粉末或颗粒物料通过施加压力制成具有一定形状、密度和强度的片状样品,其应用场景涵盖材料、化学、制药、能源等多个领域。



此款压片机体积小,压力大,压力控制精度高,现已应用于科研、教学、检测、制药、催化、化工等各个行业。此外本产品还可与傅立叶红外光谱仪、荧光光谱仪等测试仪器配套制样使用,可替代同类进口产品。

● 主要参数

• 整机尺寸	L470*D415*H800mm
• 压力范围	0~15T
• 活塞直径	Φ80mm (镀铬油缸)
• 模具加热温度	RT~300.0°C/500.0°C
• 控温精度	±0.1°C
• 隔热方式	进口隔热板
• 真空规	进口宽范围真空规
• 控制硬件	PLC 控制系统



| 售后服务

服务内容



- 1、保修期：验收合格后1年内。保修期内设备因质量缺陷出现故障，我方提供维修服务；
- 2、免费提供安装指导及设备调试服务；
- 3、终身优惠价提供易损部件及相关耗材，并协助用户进行设备维护及配件更换；
- 4、可为用户培训技术操作人员，免收培训费。食、宿、交通费用自理；
- 5、可为用户提供相关设备在不同场合使用方法及技术指导工作。

增值服务



- 1、技术人员到现场调试时将对用户操作人员进行现场讲解和操作培训，使操作人员具有独立操作的能力；
- 2、每年定期举行用户集中培训，对用户操作、管理人员进行理论、实践培训；
- 3、公司售后服务人员会定期或不定期回访，并辅之“问候式服务”，保证服务系统畅通；
- 4、随时无偿为用户提供专业技术、设备配套咨询。

服务保障体系



- 1、公司专设售后服务中心，开通24小时报修电话，接到报修电话，维修人员将在1-2个工作日内提供相应技术支持；
- 2、服务中心专人专线负责解答用户在设备使用过程中的种种问题；
- 3、联系电话：0371-55199322。

郑州成越科学仪器有限公司

Zhengzhou CY Scientific Instruments Co., Ltd.

电话:400-800-1730

手机:138-3718-9935

电子邮箱:wjb@cykeyi.com

公司网址:www.cykeyi.com

公司地址:郑州市高新区金盏街郑州亿达科技新城5号楼二楼201

